

高周波・ミリ波用 HIRAI PRECISION LTCC

(青字 : under dev./plan)

1. LTCC構成要素の特徴 (配線基板からの脱皮)

配線メタル	高Q薄膜銅ファインパターン(表裏層)、自社内メッキ、抵抗体
誘電体	大サイズ、薄層、複合材($\epsilon_r=5/6/7/18$)、PIハイブリッドキャビティ・3D構造、キャストレーション、マイクロ波焼成
ビアホール	$\phi 80\mu\text{m}$ (パッドレス)、 $\phi 30\mu\text{m}$ (UV-YAGレーザ)

2. 用途:RF・ミリ波フロントエンドモジュール(FEM)、高集積・SiP・アンテナ

展示品

- ① コンボWLAN FEM-内層2.4GHz/5GHzダイプレクサー
- ② RFコンポーネント (マイクロ波焼成試作品)
- ③ 高Q薄膜銅-評価用見本パターン

3. 提供可能なサービス

RFエレメントデザインライブラリー	(coming soon)
データセキュリティ	パスワード附与暗号化データ伝送
検査、測定評価	DC O/S & RF (67GHz迄)
短納期	1週間 (開発試作用ファウンドリーサービス)
ビジネス/開発パートナーシップ	(完了迄のプライシング応談)

4. 製品開発ロードマップ

